

1. Record Nr.	UNINA9910824582703321
Titolo	Lead-free soldering process development and reliability // edited by Jasbir Bath
Pubbl/distr/stampa	Hoboken, New Jersey : , : Wiley, , 2020
ISBN	1-119-48204-6 1-119-48209-7
Descrizione fisica	1 online resource (515 pages)
Collana	Wiley Series in Quality & Reliability Engineering
Disciplina	621.381/046
Soggetti	Electronic packaging Solder and soldering
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.